

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte  
Anmeldung per Post, E-Mail oder Fax

- im Umschlag an die vorgedruckte Adresse
- per E-Mail an [service@faps-tt.de](mailto:service@faps-tt.de)
- per Fax an +49 911 5302-9070

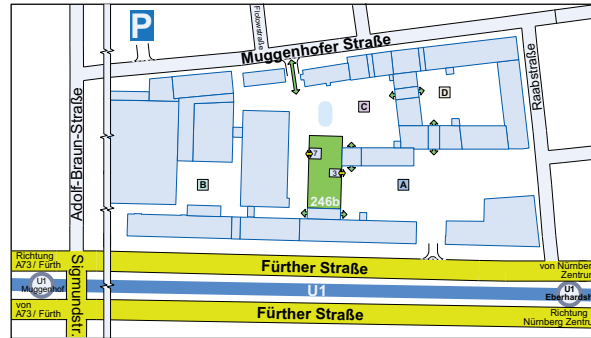
Titel, Vorname, Name \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Abteilung \_\_\_\_\_  
 Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Ich melde mich an für das Fachseminar  
**Elektronikproduktion -  
 Aktuelle Entwicklungen zu Produktionsprozessen  
 der Leistungselektronik**  
 22.11.2012:

**Antwort**  
 FAPS-TT GmbH  
 Fürther Straße 246b  
 90429 Nürnberg

**Anfahrtsbeschreibung**

FAPS, Standort Auf AEG



Navigation: Muggenhofer Straße 166, 90429 Nürnberg

**Veranstaltungsort:**

Auf AEG, Fürther Straße 246b, 90429 Nürnberg

**Anmeldung:**

Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung mit Vorlage der Anmeldebestätigung. Verwenden Sie bitte zur Anmeldung die vorgedruckte Antwortkarte. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Registrierung erfolgt nach Eingangsdatum.

**Teilnahmegebühr und Leistungen:**

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 420,- € zzgl. MwSt. ist nach Rechnungsstellung auf das dort angegebene Konto zu überweisen und schließt Tagungsunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen mit ein.

**Rücktritt:**

Bei Rücktritt bis zu 10 Tagen vor dem Seminar erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € zzgl. MwSt. Nach dieser Frist ist die Teilnahmegebühr gemäß Rechnung zu zahlen. Die Seminarunterlagen werden dann zugesandt.

**Weitere Informationen:**

FAPS-TT GmbH - Anja Stöckigt  
 Telefon: +49 911 5302-9103  
 Telefax: +49 911 5302-9070  
 E-Mail: [service@faps-tt.de](mailto:service@faps-tt.de)

**Ankündigung weiterer Veranstaltungen:**

06.02.2013: Fachseminar E|Home, Nürnberg Auf AEG  
 27.-28.02.2013: Seminar Technical Due Diligence, Frankfurt  
 14.03.2013: Fachseminar Biomechatronik, Erlangen

in Kooperation mit:



Fachseminar

**Elektronikproduktion -  
 Aktuelle Entwicklungen zu  
 Produktionsprozessen der  
 Leistungselektronik**

- Materialien, Komponenten und Fertigungsprozesse
- Neue Herausforderungen aus stationären und mobilen Anwendungen
- Ausgewiesene Referenten aus Industrie und Wissenschaft

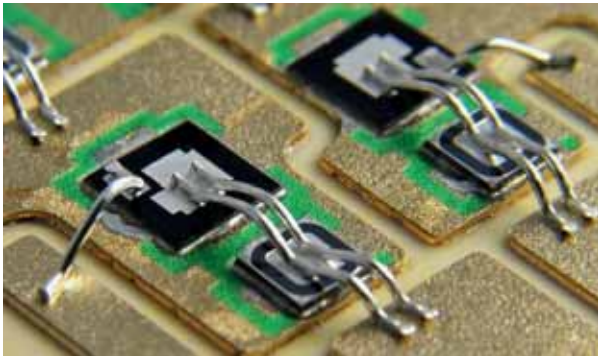
**22. November 2012  
 Nürnberg**

Auf AEG  
 Fürther Straße 246b

Fachliche Leitung:  
 Prof. Dr.-Ing. J. Franke,  
 Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung  
 und Produktionssystematik

## Thema

Die Forderung nach ressourcenschonenden Energiewandlern sowie nachhaltigen Mobilitätskonzepten hat zu einem rasanten Wachstum im Bereich der Leistungselektronik geführt. Als Querschnittstechnologie ist die Leistungselektronik zum Schlüssel für eine effiziente Ressourcennutzung geworden. Dabei müssen zur Erzielung optimaler Energieeffizienz bei leistungselektronischen Systemen alle Prozesse entlang der Wertschöpfungskette von der Auslegung der Komponenten über die Aufbau- und Verbindungstechnik bis hin zur Systemintegration optimiert und innoviert werden.



Im Rahmen dieses Seminars stellen erfahrene Experten aus Industrie und Wissenschaft neue Ansätze zur Technologieoptimierung und ihre Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung vor.

Ziel der Veranstaltung ist es, einen aktuellen Informationstransfer mit Vorträgen, ergänzenden Fachdiskussionen sowie Vorführungen in der Forschungsfabrik zu bieten. Das Forum der Forschungsfabrik Nürnberg Auf AEG mit dem neuen Labor für Leistungselektronik (PEP-Lab) bietet dazu beste Möglichkeiten. Das Tagesprogramm bietet Gelegenheit zur Diskussion individueller Problemstellungen und spezifischer Sachfragen zur Aufbau- und Verbindungstechnik.

## Programm - Vormittag

## Einführung

- 09:00 **Begrüßung und Moderation**  
Rüdiger Busch  
Clustermanager Nordbayern, Cluster  
Mechatronik & Automation e.V.
- 09:05 **Prozesse und Anlagen für die Leistungselektronik**  
Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke  
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 09:30 **Zuverlässige Leistungsmodul für  $T_{j,max} \leq 200 \text{ °C}$  durch neue Verbindungstechnologien**  
Dr. Uwe Scheuermann  
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nürnberg
- 10:00 *Kaffeepause*

## Auslegung der Komponenten

- 10:30 **Leiterplattentechnologien für die Leistungselektronik**  
Ralph Fiehler  
KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf
- 11:00 **Funktionell integrierte Leistungshalbleitermodule: Motivation, Stand der Technik und Ausblick**  
Dr. Peter Kanschäp  
Infineon Technologies AG, Neubiberg
- 11:30 **Löt- und Sinter-Pastensysteme für die AVT in Leistungsmodulen**  
Wolfgang Schmidt  
Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG,  
Hanau
- 12:00 *Mittagspause*

*Falls Sie spezifische Fragen oder Interessen haben - nennen Sie uns Ihre Anliegen gerne vorab.*

## Programm - Nachmittag

## Aufbau- und Verbindungstechnik

- 13:00 **Neue Drahtbond-Technologien: Kupfer, Bändchen und Anderes**  
Dr. Josef Sedlmair  
F & K Delvotec Bondtechnik GmbH, Ottobrunn
- 13:30 **Innovatives Löten mit Nanotechnologie**  
Norbert Heilmann  
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG, München
- 14:00 **Vakuumlöten mit der Dampfphase**  
Andreas Thumm  
IBL-Löttechnik GmbH, Ebermannstadt
- 14:30 *Kaffeepause*
- Künftige Herausforderungen**
- 15:00 **Technologiebaukasten Embedding - Integration von Bauteilen in die Leiterplatte**  
Alexander Neumann  
Schweizer Electronic AG, Schramberg
- 15:30 **Projekt ProPower - Integration effizienter Aufbau- und Verbindungstechnik für zuverlässige Leistungs-Logik-Module**  
Martin Müller  
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 16:00 **Abschlussdiskussion und Fragen**
- 16:30 **Laborbesichtigung**  
im Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion mit Versuchshalle, Messraum und Prüflabors